



各 位

平成 14 年 2 月 6 日

## 平成 14 年 3 月期 第 3 四半期の業績等の概況

上場会社名 メック株式会社  
 (コード番号: 4971 大証NJスタンダード)  
 本社所在地 兵庫県尼崎市昭和通3丁目9番地  
 問合せ先 社長室長 坂本 佳宏  
 TEL 06 - 6414 - 3451

## 1 業績

(注) 百万円未満切捨て

(1) 平成 14 年 3 月期 第 3 四半期 (平成 13 年 4 月 1 日 ~ 平成 13 年 12 月 31 日) の連結業績

	平成 14 年 3 月期 第 3 四半期 (当四半期)	対前年同期増減率	平成 13 年 3 月期 第 3 四半期 (前年同四半期)	参 考 前期 (通期)
	百万円	%	百万円	百万円
売上高	3,854	20.8	4,866	6,483
営業利益	358	62.5	958	1,102
経常利益	336	63.7	926	1,096

(注) 記載金額は、平成 14 年 3 月期第 3 四半期の連結の業績であり単体の業績につきましては、「4 その他 第 3 四半期の単体の業績」に記載しております。

(2) 部門別の連結売上高内訳

	平成 14 年 3 月期 第 3 四半期 (当四半期)		対前年同期増減率	平成 13 年 3 月期 第 3 四半期 (前年同四半期)		参 考 前期 (通期)	
	金 額	構成比		金 額	構成比	金 額	構成比
	百万円	%	%	百万円	%	百万円	%
電子基板用薬品	3,178	82.5	17.0	3,828	78.7	5,067	78.2
電子基板用機械	448	11.6	37.0	711	14.6	987	15.2
電子基板用資材	194	5.0	22.7	251	5.2	333	5.1
そ の 他	32	0.9	55.7	74	1.5	94	1.5
合 計	3,854	100.0	20.8	4,866	100.0	6,483	100.0

(3) 主な資産・負債の変動について

項目	平成14年3月期 第3四半期 (当四半期)	増減額	前期末
(資産)	百万円	百万円	百万円
受取手形及び売掛金	1,896	626	2,523
有価証券	100	172	272
流動資産「その他」	230	146	83
有形固定資産「その他」	397	268	128
(負債)			
支払手形及び買掛金	472	427	899
短期借入金	700	140	840
未払法人税等	56	159	215
流動負債「その他」	90	184	274
長期借入金	260	237	22

(注) 1. 項目ごとの変動額が、総資産額の2%を超えるものを記載いたしております。

2. 当四半期に係る数値について、公認会計士または監査法人の監査を受けておりません。

## 2 業績の概況

当社の薬品は、携帯電話やパソコン等の情報通信機器を始め、デジタル家電や自動車、医療検査機器など全てのエレクトロニクス機器に用いられる電子基板の製造工程で使用されております。

当第3四半期の当社グループを取巻く環境は、日欧米ともに景気後退がより鮮明となり、個人消費の低迷、設備投資の抑制など、より一層厳しさが増しております。電子基板業界は、情報通信機器の低迷を受け、世界的に需要が伸び悩みました。また、中国本土への生産シフトも引き続き進んでおります。

このような状況下で当社は世界市場での競争力を強化するために、新研究棟の増設により製品開発体制の充実に取組んだほか、急成長しつつある中国(江蘇省蘇州市)における生産販売拠点開設を推進いたしました。

当社グループの当四半期連結業績の概要は以下の通りであります。

### (1) 売上高

当第3四半期の売上高は、38億54百万円(対前年同期比79.2%)となりました。

当社グループは、顧客に対するきめ細かい技術的サポートを重点においた営業活動を積極的に行いました。しかしながら電子基板生産量は、情報通信機器を始めとするエレクトロニクス機器の世界的な低迷により減少しております。そのため電子基板用薬品の売上高は31億78百万円(対前年同期比83.0%)と低調に推移いたしました。高密度電子基板用途の割合が高い銅表面超粗化剤CZシリーズを含む銅表面処理剤が17億88百万円(対前年同期比85.6%)となりました。その他、銅表面を有機皮膜で保護する防錆剤は4億1百万円(対前年同期比85.6%)、銅表面をはんだで保護する際に用いるフラックス剤が6億56百万円(対前年同期比81.7%)、はんだを溶解除去するメタルレジスト剥離剤が2億33百万円(対前年同期比63.1%)となりました。

電子基板用機械の売上高は、4億48百万円(対前年同期比63.0%)と設備投資低迷の影響を受ける結果となりました。

### (2) 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は17億60百万円(対前年同期比103.3%)となりました。これは主に研究開発要員と中国を中心とするアジア地域の営業要員増強により、人件費が増加したためであります。

(3) 営業利益及び経常利益

以上の結果、営業利益は3億58百万円(対前年同期比37.5%)で経常利益は3億36百万円(対前年同期比36.3%)となりました。

3 当期の見通し

今後の世界経済の動向は、引き続き調整局面にあり厳しい状態が続くものと思われま。しかしながら電子基板は中国を中心とした日本を除くアジアでは生産増加の傾向が見込まれており、これらの地域では本格回復に向けた緩やかな動きが期待されております。

当社グループは中国での子会社設立に伴い、これら地域の販売に注力するため経営資源を集中投入していく所存であります。また、引き続き製造コストと販売費及び一般管理費の抑制を徹底し収益体質の強化を推進してまいります。

なお通期(平成13年4月1日～平成14年3月31日)の見通しにつきましては、平成13年11月20日の中間決算発表に下記の通り公表した連結・単体業績予想と、現時点では変更はございません。

平成14年3月期の連結業績予想(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	5,177	469	285

(参考) 1株当たり予想当期純利益(連結) 56円75銭

平成14年3月期の業績予想(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	4,002	217	123	15	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 24円52銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控え下さい。

4 その他

第3四半期の単体の業績

	平成14年3月期 第3四半期 (当四半期)
	百万円
売上高	2,981
営業利益	195
経常利益	144

以上